

Galaxy S8搭載、Snapdragon 835 (US版)とExynos 8895 (韓国版)のプロセッサパッケージにおける実装構造の比較

株式会社エルテックでは、Galaxy S8搭載のモバイルプロセッサの実装構造についての構造解析レポートをリリース致しました。



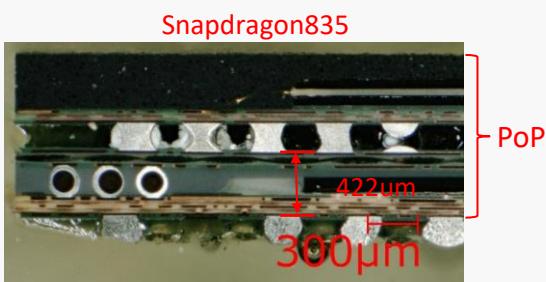
Galaxy S8 (米Qualcomm)
Snapdragon 835



Galaxy S8 (Samsung)
Exynos 8895



iPhone7
A10



PKG端部断面像



PKG端部断面像

Galaxy S8搭載のモバイルプロセッサは、米国及び英国向けに米Qualcommの「Snapdragon 835」を採用する一方、他地域向けには自社開発の「Exynos 8895」を採用しています。

本解析より、上記2つのモバイルプロセッサの実装構造について以下の違いが確認出来ました。(PoP下段)

- ・パッケージの封止構造
- ・電極構造
- ・受動素子の実装位置

また本レポートでは、比較対象としてiPhone7搭載のA10(TSMC Fan-Out)のデータも掲載し、3製品での比較レポートとします。(全44ページ)

販売価格(税別)¥200,000

17G-0011-1

Table of Contents

	Page
1. デバイスサマリー	... 3
2. 解析結果まとめ	... 4~7
3. 考察	... 8~10
4. 製品概要	
4-1 Snapdragon835	... 11
4-2 Exynos8895	... 12
4-3 A10	... 13
5. 外観観察	
5-1 Snapdragon835	... 14~16
5-2 Exynos8895	... 17~18
5-3 A10	... 19
6. 断面観察	... 20~21
7. 断面詳細観察(下段パッケージ)	
7-1 Snapdragon835	... 22~27
7-2 Exynos8895	... 28~34
7-3 A10	... 35~37
8. 平面詳細解析(下段パッケージ)	
8-1 Snapdragon835	... 38~40
8-2 Exynos8895	... 41~42
8-3 A10	... 43~44